

# **ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ПРЕКУРСОРІВ ДЛЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ НА ОСНОВІ CIS**

**Клочко Н. П.<sup>1</sup>, Копач Г. І.<sup>1</sup>, Волкова Н. Д.<sup>2</sup>, Любов В. М.<sup>1</sup>,  
Момотенко О. В.<sup>1</sup>, Копач А. В.<sup>1</sup>, Харченко М. М.<sup>1</sup>, Новіков В. О.<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків  
<sup>2</sup>Національний аерокосмічний університет  
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків**

Тонкоплівкові сонячні елементи на основі електроосадженого з прекурсорів  $\text{CuInSe}_2$  (CIS) демонструють рекордне значення коефіцієнту корисної дії (ККД) - понад 11%. Проте, в процесі сумісного одностадійного електроосадження на поверхню молібденової підкладки плівок Cu, In та Se в потенціостатичному режимі виникають труднощі, пов'язані з контролем хімічного складу зразка. На наш погляд, послідовне електроосадження тонких плівок прекурсорів є перспективним методом виробництва сонячних елементів на основі CIS і, тому, ця робота присвячена дослідженню структури та фізичних властивостей різних електроосаджених композицій Cu-In-Se для отримання оптимальних поєднань.

Електрохімічне осадження міді, індію та селену проводилось при кімнатній температурі в двохелектродній комірці з простих водних електролітів без використання органічних добавок. Рентген-дифрактометричне дослідження структури електроосаджених плівок виконувалось на дифрактометрі ДРОН-4 з фокусуванням по Бреггу-Брентано у випромінюванні кобальтового аноду. Прецизійне визначення періоду решітки електроосаджених шарів здійснювалось за методом Нельсона та Рілі, дослідження переважної орієнтації плівок - шляхом аналізу дифракційних максимумів і розрахунку параметрів текстури, обчислення розміру кристалітів - за допомогою формули Вільямсона-Холла.

Аналіз кристалічної структури, морфології поверхні та фізико-механічних властивостей електроосаджених плівок та їх композицій показав, що послідовність Cu-In-Se має найбільш оптимальні характеристики. Зокрема, утворення інтерметалічних сполук  $\text{InCu}$  та  $\text{Cu}_2\text{In}$  при електроосадженні In на Cu сприяє поліпшенню адгезії до матеріалу підкладки, фаза  $\text{In}_2\text{Se}_3$ , що утворюється в процесі електроосадження Se на In, має порівняно досконалу структуру, в той час як безпосередній контакт Cu і Se небажаний через утворення кристалічної фази  $\text{Cu}_2\text{Se}$  зі значними напруженнями у структурі.